



インテルとマイクロン

テクノロジー社3ビット/セル技術を採用した業界で最もコスト効率に優れたNAND技術を開発

～ 34nm プロセス技術を活用し、32ギガ・ビット製品を提供へ ～

Boise, Idaho and Santa Clara, California , 2009年8月11日 – インテル

コーポレーション（本社：米国カリフォルニア州サンタクララ）とマイクロン

テクノロジー社（本社：米国アイダホ州ボイジー）は、34nm（ナノメートル）プロセス技術および多値セル技術を採用した最新の3ビット/セルNAND技術を開発したと発表しました。この技術は、フラッシュメモリ、USBメモリなどの集積度の高さとコスト効率が最重要視される一般消費者向け記録媒体に利用される予定です。

今回開発された最新技術は、両社の合併会社であるIMフラッシュ・テクノロジーズ（IMFT）によって設計、製造されたものです。新しい3ビット/セル

NAND技術により、業界最小で、最もコスト効率に優れた32ギガ・ビット製品を製造することができます。3ビット/セル技術を採用した32ギガ・ビット版NAND製品のダイサイズは、126平方ミリメートルです。マイクロンは、現在サンプル出荷を開始しており、2009年第4四半期の量産出荷を予定しています。両社は引き続きダイサイズの縮小に取り組み、製品戦略の重要な役割を担う3ビット/セルNAND技術を確立し、主要な市場に向けてコスト効率に優れた製品を提供する計画です。

マイクロン

テクノロジー社のメモリ部門担当副社長のブライアン・シャーリーは「3ビット/セルNAND技術は我々のロードマップにおいて重要な進展を示します。我々は引き続きNANDの縮小に向けた取り組みに尽力し、今後も世界トップクラスの製品ポートフォリオを顧客に提供していきます。本日の発表はマイクロンとインテルの34nmプロセス技術を採用したNAND製品における大きな躍進を示し、我々は次世代の30nm以下のプロセス技術を2009年後半に紹介することを楽しみにしています」と述べています。

インテル コーポレーション 副社長 兼

NANDソリューション事業部長のランディ・ウィルヘルムは「3ビット/セル技術への移行は、インテルとマイクロンの34nmプロセス技術における著しい進歩を意味しています。今回発表の画期的な成果は将来の30nm以下のプロセス技術におけるシリコンのリーダーシップを推進し、顧客のコスト削減の支援とNANDソリューションの可能性を拡大させるでしょう」と述べています。

関連リンク

以下のサイトでもインテルおよびマイクロン

テクノロジー社の最新ニュースをご覧くださいことができます。

- Micron Innovations Blog: www.micronblogs.com
- Micron on Twitter: <http://twitter.com/microntechpr>
- Intel Pressroom: www.intel.com/pressroom
- Intel Blog: www.blogs.intel.com
- Intel on Twitter: <http://twitter.com/intelnews>

インテルについて

シリコンの技術革新で世界をリードするインテルは、人々の仕事と生活をさらに豊かにする先進的な技術と製品を開発、イニシアチブを推進していきます。インテルに関する情報は、<http://www.intel.co.jp>で入手できます。

マイクロン テクノロジー社について

マイクロン

テクノロジー社は、先進的な半導体ソリューションを提供する世界的大手企業です。マイクロンは、世界全域での事業活動を通じ、最先端のコンピューター、家電製品、ネットワーキング、モバイル機器などに使用される、DRAM、NANDフラッシュメモリ、その他半導体部品とメモリモジュールなどを製造・販売しています。マイクロン

テクノロジー社の普通株式はニューヨーク証券取引所（NYSE）にMUのコード名で上場取引されています。マイクロン テクノロジー社に関する情報は、www.micron.comをご覧ください。

* マイクロンおよびマイクロンのロゴは、マイクロン テクノロジー社の商標です。

* Intel、インテル、Intelロゴは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。その他の社名、製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。

このプレスリリースは、3ビット/セル 32ギガビット

NANDデバイスの生産に関する「将来予測表明」を含んでいます。実際の事象や結果は、「将来予測表明」に含まれたものと実質的に異なる可能性があります。マイクロン社が、時宜を得て、米証券取引委員会に提出した連結ベースの書類、具体的には、当社直近の「10-K」と「10-Q」を参照願います。これらの書類は、実際の結果が当社にとり連結ベースで当社の、「将来予測表明」（「一部の要因」参照）に記載されたものと実質的に異なる原因となり得る重要な要因を含むと共に、それらを特定しています。「将来予測表明」に反映された期待は妥当なものと思われませんが、当社は将来の結果、活動のレベル、実績、業績などを保証することはできません。

CONTACT:

Micron Technology, Inc.
Kirstin Bordner
Phone +1-208-368-5487
kbordner@micron.com

Deborah Paquin
For Intel Corporation
916-984-1921
debpaquin@strategiccom.biz

Bill Kircos
Intel Corporation
480-552-2815
bill.kircos@intel.com